

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽，須與本文件全文一併閱讀。由於此乃概要，故並無載列可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下於決定投資[編纂]前，務須閱讀整份[編纂]，包括我們的財務報表及隨附附註。投資[編纂]的若干特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下投資[編纂]前須仔細閱讀該節。本節所用各種表述的釋義載於本文件「釋義」及「技術詞彙」。

概覽

我們成立於二零零五年，為一家領先的托盤及托盤相關產品的後段半導體傳輸介質製造商，於往績記錄期間，我們的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。除專注於托盤及托盤相關產品的設計、開發、製造及銷售，我們亦自二零一九年起將載帶納入我們的產品類別。除半導體傳輸媒體外，我們亦提供MEMS及傳感器封裝解決方案。根據F&S報告，於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，我們於二零二零年排名全球第三，市場份額約為7.6%。

我們的後段半導體傳輸媒體產品（即托盤及載帶）主要用於半導體器件的保護，包括功率分立半導體器件、光電、集成電路及傳感器等。我們的托盤及載帶於托盤或膠帶錶面專為容納、安全處理、運輸及存儲不同半導體器件而設計，包括功率分立半導體器件、光電器件、IC及傳感器，具有ESD保護及高耐熱性。我們的MEMS及傳感器封裝解決方案提供一個外殼，旨在促進向電子設備的電路板傳遞信號的電觸點，並保護MEMS及傳感器免受潛在的外部元件損壞及老化的腐蝕影響。於研發及材料工程部及銷售和市場推廣人員以及可定制的製造平台及設計支持服務的支持下，我們能夠滿足客戶的各種特定要求，並簡化及時完成於條款上優化的複雜設計成本及性能。於往績記錄期間，我們已開發超過1,300種不同尺寸的多元化產品組合，具有不同的熱、機械及物理性能指標，滿足客戶的規格及所需的質量標準。

我們於中國東莞設立兩個生產廠房。於最後實際可行日期，我們擁有四個生產設施，其中兩個負責製造托盤及托盤相關產品，其餘各負責生產載帶及MEMS及傳感器封裝解決方案。根據F&S報告，後段半導體傳輸介質行業的全球市場規模將由二零二一年的約881.8百萬美元以7.4%的複合年增長率增長至約二零二五年約12億美元，而全球MEMS及傳感器封裝行業市場規模將由二零二一年的約52億美元增長至二零二五年的約69億美元，複合年增長率為7.2%。為把握後段半導體傳輸介質行業和MEMS及傳感器封裝解決方案行業的市場增長，我們計劃通過升級我們於中國的生產設施（特別是購買自動化機器及於菲律賓開始生產載帶）。

我們的產品及業務模式

我們的產品一般可分為三類：(i)托盤及托盤相關產品；(ii) MEMS及傳感器封裝解決方案；及(iii)載帶。我們所有產品均符合RoHS及REACH標準，以滿足所需的行業標準。有關我們產品的詳情，請參閱本文件「業務－我們的產品」。

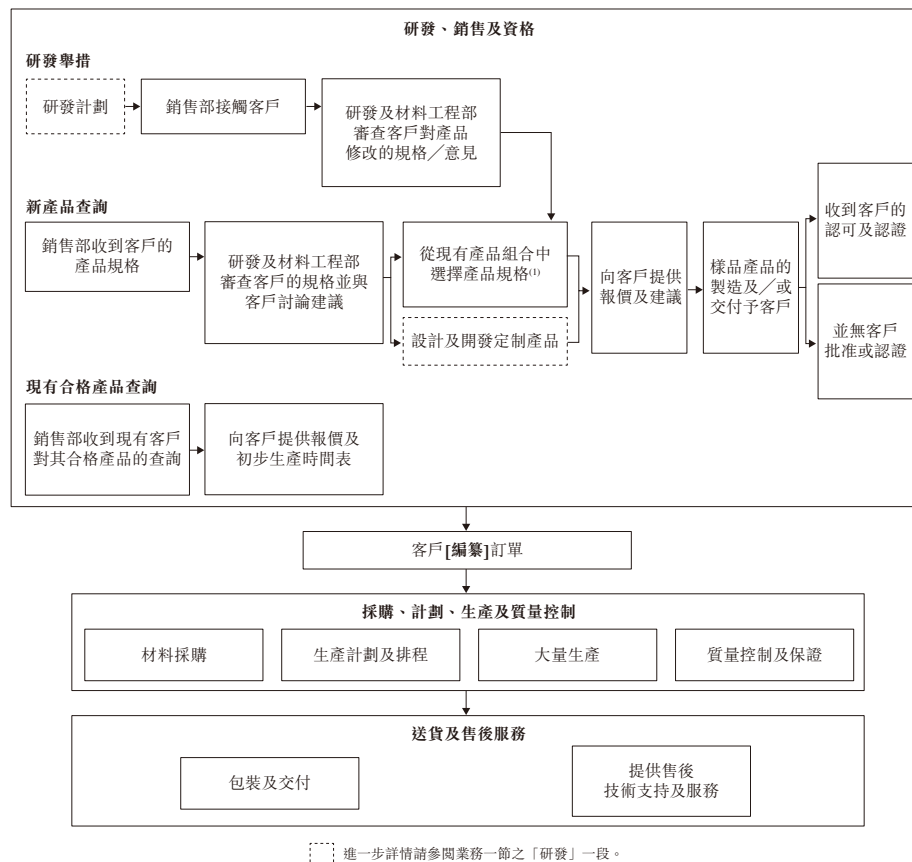
概 要

以下載列本集團於往績記錄期間按產品類別劃分的收入明細：

	截至十二月三十一日止年度		二零二一年	
	二零二零年	佔總數的 百分比 %	二零二一年	佔總數的 百分比 %
	收入 千港元		收入 千港元	
托盤及托盤相關	157,303	94.8	195,429	96.3
MEMS及傳感器產品封裝	8,467	5.1	7,152	3.5
載帶	209	0.1	367	0.2
合計	165,979	100.0	202,948	100.0

我們的收益由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約166.0百萬港元增加約22.3%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約202.9百萬港元，其中大部分收益來自銷售托盤及托盤相關產品，其中分別佔我們截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度總收入的約94.8%及96.3%。我們的純利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約12.4百萬港元增加約112.8%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約26.4百萬港元。

下圖說明我們營運的營運模式：



(1)：我們現有產品組合包括(i)由我們的研發項目開發的新產品規格及(ii)我們為客戶開發的產品規格。於最後實際可行日期，我們的產品組合包括超過1,300種產品規格。

概 要

有關我們業務模式的詳情，請參閱本文件「業務－我們的業務模式」。

我們的客戶

經過超過15年的發展，我們已建立廣泛的客戶群，包括若干世界領先的IDM公司、無晶圓廠半導體公司及IC封裝測試機構，例如STMicroelectronics。截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們約27.3%的收入來自中國的客戶。為貼近客戶，我們於香港設立總部，並於香港、東莞、中國及新加坡設有三個銷售辦公室以及於全球設有八個銷售點，其中我們聘請銷售代表，分別位於(i)中國上海，(ii)台灣臺北，(iii)台灣高雄，(iv)韓國首爾，(v)馬來西亞馬六甲，(vi)歐洲意大利，(vii)美國亞利桑那州及(viii)菲律賓。由於我們已於全球發展後段半導體傳輸介質行業的既定客戶。我們打算繼續與我們的全球客戶密切合作，並利用我們的規模及技術領先地位，進一步抓住快速發展的半導體行業的機遇（尤其是於中國）。

下表載列我們於往績記錄期間按地區劃分的收入明細：

	十二月三十一日止年度			
	二零二零年		二零二一年	
	收入	佔總數的	收入	佔總數的
	千港元	百分比	千港元	百分比
		%		%
東南亞	63,808	38.4	72,219	35.6
中國	32,880	19.8	55,495	27.3
台灣	33,924	20.4	39,195	19.3
美國	17,798	10.7	16,782	8.3
歐洲	3,896	2.4	3,433	1.7
香港、韓國及日本	13,673	8.3	15,824	7.8
合共	<u>165,979</u>	<u>100.0</u>	<u>202,948</u>	<u>100.0</u>

於往績記錄期間，我們的五大客戶已向本集團購買產品超過10年。據本公司董事所知，於往績記錄期間，本公司董事或其聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東均未於本集團的任何五大客戶中擁有任何權益。

於往績記錄期間，截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們的五個最大客戶分別佔我們總營業額的約63.7%及60.9%，而我們的最大客戶佔各年度的總營業額約21.2%及20.6%。有關客戶的詳情，請參閱本文件「業務－客戶－主要客戶」。

我們的供應商

我們認為，我們的成功很大程度上取決於我們通過提供廣泛的優質產品組合以定制客戶於生產中的需求能力。因此，以合理的價格穩定供應優質產品乃本集團選擇供應商以靈活適應生產的重點之一。我們業務的重要塑膠材料包括原料塑膠材料、再生塑膠材料、再複合塑膠材料及配製塑膠材料。董事認為，由市場上有大量供應商，因此將能夠以合理的成本及時找到替代塑膠材料供應商。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到與供應商有關的營運出現任何重大產能不足、供應短缺、延誤或中斷，或供應商應佔任何重大產品索賠。

概 要

據本公司董事所知，於往績記錄期間，本公司董事或其聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東均未於本集團的任何五大供應商中擁有任何權益。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們的五大供應商分別佔採購總額約61.7%及55.2%，而最大供應商則分別佔相關期間的採購總額約19.9%及15.9%。有關供應商的詳情，請參閱本文件「業務－採購及供應商－主要供應商」。

競爭優勢及業務策略

我們相信以下競爭優勢有助於我們取得成功：(i)我們的業務由半導體行業驅動，將受益於快速增長的全球半導體行業；(ii)我們於後段半導體傳輸介質行業的穩固地位使我們能夠於中國及海外市場快速增長的半導體行業中進一步尋求載帶及其他新產品的銷售機會；(iii)具有研發及產品開發能力的垂直整合業務模式以及自營生產廠房使我們能夠為客戶提供全面的產品組合；(iv)與半導體行業的主要國際客戶建立廣泛而穩固的關係，並擁有良好的聲譽及良好的業績記錄；(v)我們於銷售辦事處及不同銷售點的銷售及市場推廣人員的支持下，建立具有深度市場滲透的全球銷售網絡；及(iv)經驗豐富的管理團隊及具有深厚行業知識的銷售及生產人員。

為了實現可持續增長及成功的願景，我們打算採取以下戰略：(i)通過促進生產過程的自動化、升級生產設施及購買必要的機器以提高我們的產能和能力，其中包括升級我們於中國的生產設施並於菲律賓實施載帶生產；(ii)加強我們於全球市場(包括中國市場)的銷售及營銷力度；(iii)採購ERP系統及升級資訊系統以提高效率並降低成本；及(iv)進一步加強我們的研發能力，以擴大我們的產品供應、原材料和生產技術。

股東資料

緊隨[編纂]及[編纂](不計及本公司行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)，Sino Success(由湯先生全資擁有)完成後及生意(分別由鄧先生擁有70.2%、鄧女士擁有5.0%、鄧澤良先生擁有12.4%及鄧澤民先生擁有12.4%權益)將分別擁有[編纂]及[編纂]本公司已發行股本。綜上所述，根據GEM上市規則，Sino Success、湯先生、生意、鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生為本公司的一組控股股東。

除上文所披露者外，概無其他人士將於緊隨[編纂]及[編纂](不計及本公司根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)完成後有權於本公司股東大會上行使或控制行使30%或以上的投票權。

概 要

於二零二二年三月二十五日，湯先生及生意訂立一致行動確認，以承認及確認(其中包括)於往績記錄期間及直至一致行動確認日期(包括當日)，彼等為優博企業的一致行動人士。根據一致行動確認，彼等進一步承認、確認及同意只要彼等仍為優博企業的主要管理層成員及／或仍於優博企業的股本中持有權益(不論直接或間接權益)，彼等須繼續就優博企業採取一致行動。更多詳情請參閱「與我們的控股股東的關係－控股股東」。

此外，於往績記錄期間，本集團與若干關連人士進行交易，而根據GEM上市規則，該等交易將於[編纂]後繼續進行並構成關連交易，其中部分交易獲完全豁免遵守GEM上市規則的申報、公告、年度審核、通函及獨立股東批准規定。該等關連人士包括成田置業、東莞柏輝及金柏科技。於最後實際可行日期，成田置業由東莞柏輝(為於中國註冊成立之有限責任公司)擁有30%。於最後實際可行日期，東莞柏輝由堅成實業有限公司(於香港註冊成立之有限公司，由鄧氏家族間接非全資擁有)全資擁有，因此，成田置業及東莞柏輝均為鄧氏家族各成員之聯繫人，並為本公司之關連人士。金柏科技由非執行董事張志華先生間接擁有41.4%權益。因此，根據GEM上市規則第20章[編纂]，成田置業、東莞柏輝及金柏科技各自將成為本公司之關連人士。有關更多詳情請參閱「關連交易－(I)關連交易」及「關連交易－(II)完全獲豁免持續關連交易」。

[編纂]

於二零二二年三月二十一日，因左先生個人財務原因，彼將優博企業全部[編纂]股股份(佔優博企業總股本[編纂])轉讓予湯先生，總代價為[編纂]港元，變現其對優博企業的投資。上述轉讓於同日完成，緊隨其後，優博企業由湯先生、生意、陳先生、黃女士、石先生及譚先生分別持有[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]。有關上述[編纂]的詳情，請參閱「歷史、發展及重組－公司歷史－優博企業」一節。

主要營運及財務數據

下表載列所示年份的合併損益及其他全面收益表，其詳情載於本文件附錄一，而該等表格應與本文件附錄一的財務報表(包括相關附註)一併閱讀。

概 要

合併損益及其他全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年	二零二一年
	千港元	千港元
收益	165,979	202,948
銷售成本	(107,679)	(116,272)
毛利	58,300	86,676
其他收入	1,629	74
其他收益及虧損	2,470	1,070
金融資產之減值虧損	(378)	(76)
行政開支	(22,890)	(23,827)
銷售及分銷開支	(17,160)	(22,742)
研發開支	(4,615)	(4,104)
財務成本	(3,242)	(3,209)
[編纂]	[編纂]	[編纂]
除稅前溢利	14,114	31,844
所得稅開支	(1,709)	(5,448)
年內溢利	12,405	26,396

於往績記錄期間，我們的收益主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們的收益總額分別約為166.0百萬港元及202.9百萬港元。往績記錄期間的收益增加主要歸因於我們把握中國後段半導體運輸介質行業的增長，令中國市場產生的收益增加。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，毛利分別約為58.3百萬港元及86.7百萬港元。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，來自銷售托盤及托盤相關產品的毛利分別約為55.2百萬港元及84.3百萬港元，有關增加的原因為於二零二零年至二零二一年間托盤及托盤相關產品所產生的收益增加，因勞動力成本及製造費用保持相對穩定，實現規模經濟；截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，來自銷售MEMS及傳感器封裝解決方案的毛利分別為3.1百萬港元及2.3百萬港元，有關減少的原因為MEMS及傳感器產品封裝銷售下降的同時來自優博創新微機電的MEMS及傳感器產品成本維持相對穩定；及截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，來自銷售載帶的毛利分別為63,000港元及116,000港元，有關毛利於往績記錄期間維持穩定。

鑑於上文所述，我們的年內溢利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約12.4百萬港元增加約112.8%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約26.4百萬港元。我們淨溢利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度的7.5%增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度的13.3%。我們的經調整年內溢利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約12.4百萬港元增加約129.1%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約28.4百萬港元。有關增加符合上文所述的毛利及毛利率增加。

有關更多詳情請參閱本文件「財務資料－合併損益及其他全面收益表的節選項目」一節。

概 要

合併財務狀況表的節選項目

	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	於二零二二年 二月二十八日 千港元 (未經審核)
流動資產總額	106,755	139,225	134,558
存貨	38,485	60,113	73,169
貿易及其他應收款項、按金及預付款項	42,608	63,215	43,071
流動負債總額	142,498	157,500	149,458
貿易及其他應付款項	71,502	75,648	72,271
合約負債	329	340	353
所得稅撥備	11,235	14,555	13,077
銀行透支	2,085	3,261	3,140
流動負債淨值總額	(35,743)	(18,275)	(14,900)

我們於二零二零年及二零二一年十二月三十一日分別錄得流動負債淨額約35.7百萬港元及約18.3百萬港元。於往績記錄期間，我們的流動資產主要包括存貨、貿易及其他應收款項、按金及預付款項以及應收董事款項，於二零二零年十二月三十一日分別為約38.5百萬港元、42.6百萬港元及12.2百萬港元，而於二零二一年十二月三十一日則分別為約60.1百萬港元、63.2百萬港元及10.6百萬港元。於往績記錄期間，我們的流動負債主要包括貿易及其他應付款項、銀行借款及所得稅撥備，於二零二零年十二月三十一日分別為約71.5百萬港元、50.0百萬港元及11.2百萬港元，而於二零二一年十二月三十一日則分別為約75.6百萬港元、53.6百萬港元及14.6百萬港元。

董事確認，於往績記錄期間，我們並無違約或延遲支付貿易及非貿易應付款項及借款及／或違反契約，而會導致對我們的業務、財務狀況及營運業績構成重大影響。我們會繼續定期監察流動資金需要，以確保維持充裕的營運資金。

合併現金流量表的節選項目

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元
營運資金變動前之經營現金流量	38,379	47,973
經營活動所得之現金淨額	20,836	8,186
投資活動所用之現金淨額	(33,385)	(7,819)
融資活動所得(所用)之現金淨額	17,391	(5,432)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	4,842	(5,065)
外匯匯率變動之影響	(400)	(616)
年初之現金及現金等價物	301	4,743
年末之現金及現金等價物	4,743	(938)

概 要

主要財務比率

下表載列本集團於往績記錄期間的主要財務比率：

	截至十二月三十一日止年度／ 於十二月三十一日	
	二零二零年	二零二一年
流動比率	0.75	0.88
速動比率	0.48	0.50
資本負債比率	4.21	1.51
股本回報率	100.2%	70.0%
資產回報率	7.0%	12.0%
利息覆蓋率	5.4倍	10.9倍
毛利率	35.1%	42.7%
淨溢利率	7.5%	13.0%

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年，毛利率有所增加，分別為35.1%及42.7%。有關影響毛利率因素的討論，請參閱本節「經營業績同期比較－毛利及毛利率」一段。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年，淨溢利率有所增加，分別為7.5%及13.0%。有關影響淨溢利率的因素討論，請參閱本節「經營業績同期比較－一年內溢利」一段。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日，我們的資本負債比率分別約為4.21及1.51。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日，我們的流動比率分別為0.75及0.88。

有關詳情，請參閱本文件「財務資料－主要財務比率」一節。

近期發展及概無重大不利變動

於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，我們繼續專注於設計、開發、生產及銷售托盤及托盤相關產品。我們亦開發載帶（其已自二零一九年起納入我們的產品類別）。除後段半導體運輸介質外，我們繼續為MEMS及傳感器封裝解決方案供應商。於二零二一年十二月三十一日後，於二零二二年三月三十一日，本集團向湯先生收購優博創新科技產權及優博創新微機電的全部權益作為本集團重組之一部分，以納入IC行業的生產場地。有關進一步詳情，請參閱本文件「財務資料－期後事項」及附錄一所載的會計師報告附註35。除上文所述者外，自二零二一年十二月三十一日起直至最後實際可行日期，我們的業務模式、收益結構、成本結構以及我們營運所在的行業、市場及監管環境大致上維持不變。

董事確認，直至本文件日期，我們的財務、營運及／或貿易狀況自二零二一年十二月三十一日（即我們最近期經審核合併財務資料的編製日期）以來概無重大不利變動，且自該日起直至最後實際可行日期，概無事件會對本文件附錄一所載本集團會計師報告的經審核合併財務資料所示資料造成重大影響。

概 要

[編纂]數據

[編纂]

股息

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無向當時的股東宣派及派付任何股息。

於[編纂]完成後，我們可以現金或董事認為合適的其他方式分派股息。分派任何中期股息或建議任何末期股息的決定須經董事會批准並將由董事會酌情作出。此外，任何財政年度的末期股息須經股東批准。有關股息政策的進一步詳情，請參閱「財務資料－股息及股息政策」。

[編纂]

我們的估計[編纂]主要包括有關[編纂]的法律及專業費用。假設[編纂]為每股股份[編纂](即本文件所述[編纂]範圍中位數)，並假設[編纂]未獲行使，則本公司將承擔的應付[編纂]估計約為[編纂]，其中約[編纂]直接歸因於發行新股份並將根據相關會計準則入賬為權益減項。預期餘額約[編纂]將於[編纂]後扣除。估計應付[編纂]可根據已經或將會產生的實際金額予以調整。

[編纂]

假設[編纂]為每股[編纂](即[編纂]範圍介乎[編纂]至[編纂]的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，我們估計[編纂](扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及佣金及估計開支後)將約為[編纂]。

我們擬將[編纂][編纂]用作以下用途：

- 約[編纂](或[編纂]約[編纂])將用作提高我們的產能及生產力；
- 約[編纂](或[編纂]約[編纂])將用作加強我們在全球市場(包括中國市場)的銷售及市場推廣工作；

概 要

- 約[編纂](或[編纂]約[編纂])將用作購買ERP系統及升級信息系統以支援ERP系統；
- 約[編纂](或[編纂]約[編纂])將用作加強我們的研發及材料工程的能力；及
- 約[編纂](或[編纂]約[編纂])將用作一般營運資金。

有關更多詳情，請參見本文件「未來計劃及[編纂]」。

風險因素

我們認為，我們的業務營運涉及若干風險及不確定因素，而其中眾多風險及不確定因素並非我們所能控制，其可能對本集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。我們已將四類風險分類為：(i)有關我們的業務及行業的風險；(ii)有關我們經營業務所在司法權區的風險；(iii)有關[編纂]的風險；及(iv)有關本文件所作陳述的風險。部分該等風險概述如下：

- 對我們產品的需求高度依賴於半導體行業表現及我們的客戶對產品的需求。
- 供應量的波動或原材料價格上升可能會對我們的業務造成負面影響。
- COVID-19爆發可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況及前景造成重大不利影響。
- 我們的持續成功取決於我們應對客戶及市場對技術升級要求的能力。技術進步或其他行業變化可能削減我們的產品的競爭力或報廢，從而對我們的業務、財務狀況及經營業績造成負面影響。
- 全球金融危機及經濟衰退可能對我們的業務、流動性、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響。
- 香港、中國及菲律賓經濟、政治及法律環境的不利變化可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。
- 香港、中國及菲律賓經濟、政治及法律環境的不利變化可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

該等風險並非可能影響我們股份價值的唯一重大風險。閣下應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，特別是應評估本文件「風險因素」中載列的具體風險，以決定是否投資於我們的股份。

合規與訴訟

於往績記錄期間，我們有若干情況並無完全遵守我們業務所在的法律和法規。有關詳情請參閱「業務－法律合規、牌照及許可－法律合規」。於最後實際可行日期，我們的董事並不知悉任何針對本集團的當前或未決訴訟、索賠或仲裁可能對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。詳情見「業務－訴訟及潛在索償」。